

次世代センシング・通信を拓く 微細加工・MEMS技術の新展開

New Developments in Microfabrication and MEMS Technologies
Pioneering Next-Generation Sensing and Communications

2026年3月16日(月) 13:30~17:10
東京科学大学 大岡山キャンパス & オンライン

これからの高度情報化社会を支えるIoT(モノのインターネット)では、分散した多数のセンサが様々な情報を取得して流通させることから、デバイスの高性能化・多機能化が求められている。キー技術ノロジーである半導体技術の新たな展開について、特に微細加工・MEMS技術を中心に、本分野のトップランナーよりシーズ・ニーズの両面から話題提供いただき、今後の重要な研究開発について議論する。

招待講演

菊地 克弥 産業技術総合研究所

先端デバイス集積化に向けた3次元集積実装技術



富川 真佐夫 東レ株式会社

樹脂を用いたハイブリッド接合技術



原 晋治 TDK株式会社

MEMS技術を活用した新奇構造遠赤外線イメージセンサ



信川 輝吉 NHK放送技術研究所

ホログラフィックイメージングのための微細加工技術と
メタサーフェス



三宅 丈雄 早稲田大学

次世代医療用眼レンズに向けた材料・デバイス・システム



照月 大悟 信州大学

生物嗅覚のデバイス統合による匂い追跡ドローンと
その応用展開



企画：集積化MEMS技術研究会(<http://annex.jsap.or.jp/MEMS/>)

世話人：後藤正英(NHK)、岡本有貴(産総研)、中澤寛一(ミライズテクノロジーズ)